

【レーザーJOB株式会社】

プローブカード加工技術の高度化の開発

開発のねらい

5Gの急速な普及により高度化するプローブカード加工技術の開発

開発の概要

5G世代プローブカードの要求仕様は一気に高度化した。

- ・多ピン化：穴数 10,000穴→30,000~70,000穴/枚（穴エリア拡大）
加工時間 10時間→70時間/枚

- ・高密度化：穴位置精度 $\pm 3 \mu m \rightarrow \pm 2 \mu m$

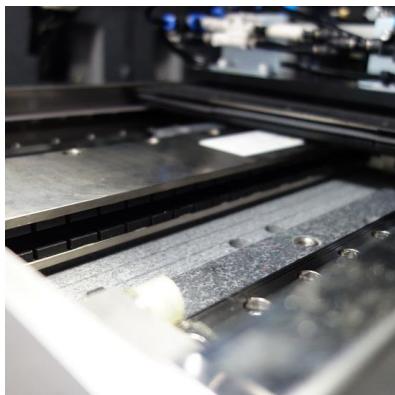
現行加工機（4G対応）では上記加工仕様を満足することができないため、加工位置精度の抜本的な改善に取り組んだ。

特長

- ・加工駆動系の変更：ボールネジ→リニアモータ駆動
- ・加工環境温度の安定化：温度調整制御システムの導入

用途

プローブカード用ガイド板の超精密穴あけ



リニアモータ駆動部



温度調整用温度センサ

お問い合わせ先

【所在地】 〒335-0038 埼玉県戸田市美女木北2-3-12

【連絡先】 TEL 048-422-4170 FAX 048-422-4175 第2技術G 増田

<http://www.laserjob.co.jp/>

k-kikaku@laserjob.co.jp

